

深圳市联得自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备 证券代码：300545

编号：2025-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员 姓名	一、7月22日 第一场：现场调研 华泰证券、北京雪球私募共4人 二、7月23日 第一场：现场调研 南方基金共2人 第二场：现场调研 宝盈基金、华福证券共2人
时间	2025年7月22日-7月23日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司会议室、深圳基金公司会议室
上市公司接待人员 姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：请介绍一下公司的主要客户有哪些？ A1： 公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、伟世通、哈曼、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、富士康、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的

紧密的合作关系。

Q2: 公司在先进封装领域有哪些布局?

A2: 公司一直积极布局半导体领域, 已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。在先进封装领域, 公司有针对性显示驱动芯片键合设备, COF 倒装设备, 该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势, 积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q3: 公司的设备应用在手机折叠屏领域发展情况如何?

A3: 公司柔性 AMOLED 贴合类设备已经广泛运用国内外知名终端客户手机折叠屏的量产。公司与国内外多家智能手机知名品牌制造商保持良好的合作关系, 并持续就柔性屏创新性作用开展深入合作。在三折屏供应链中, 公司提供的贴合类工艺设备已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业, 持续发挥技术领先优势。

Q4: 公司在固态电池业务方面进展如何?

A4: 在新能源设备领域, 公司持续增加在锂电池包蓝膜、切叠一体机、电芯装配、超声波焊接及 Pack 段整线自动化设备等设备上的研发投入, 运用先进的生产工艺、高精度的生产方式、标准化管理, 迅速实现产品突破, 并形成销售订单。固态电池新工艺涉及到的超声波焊接工艺设备已经出货到客户。

Q5: 公司在 VR/AR/MR 显示领域主要的产品和客户有哪些?

A5: 公司通过持续创新, 打破技术壁垒, 研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域, 公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备, 涵盖硅基显示、光波导贴合等众多工艺段, 相关产品已与合肥视涯及国际头部终端客户建立了合作关系。

Q6: 公司是否考虑通过并购重组来扩大经营?

A6: 公司一直持续关注相关行业动态, 积极寻求整合优质资源的机会, 将充分把握中央及地方监管机构支持上市公司并购重组、加强产业整合的政策导向, 公司将根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策。

附件清单（如有）	无
日期	2025-7-23